

2016年1月26日

各 位

会 社 名 ソニー株式会社  
代 表 者 名 代表執行役 平井 一夫  
(コード番号 6758 東証 第1部)  
問 合 せ 先 財務部 VP 村上 敦子  
(TEL: 03-6748-2111(代表))

LTE 通信向けモデムチップ技術を保有する  
イスラエル国 Altair Semiconductor(アルティア社)を買収

本日、ソニー株式会社は上記の発表を行いました。

詳細は、別添プレスリリースをご参照ください。

以 上

**LTE 通信向けモデムチップ技術を保有する  
イスラエル国 Altair Semiconductor (アルティア社) を買収**

ソニーは、Altair Semiconductor (以下、アルティア社) の買収 (以下、本件取引) について同社及びその主要株主と合意しました。買収金額は、212 百万米ドル (約 250 億円\*) です。本件取引は 2016 年 2 月初旬に完了する予定です。

アルティア社は、モバイル機器のデータ通信技術規格である LTE(Long Term Evolution) 向けモデムチップ技術とその関連ソフトウェアを有しています。イスラエル国に本社を置き、LTE 技術に特化した製品の開発と販売を行っており、高性能で低消費電力、低コストのモデムチップ製品等を提供しています。

LTE とは、既に携帯電話のデータ通信で幅広く利用されている、第 4 世代移動通信システム(4G) のデータ通信技術規格で、IoT(Internet of Things、モノのインターネット) を実現する通信手段の一つとしても有望視されています。今後、様々なモノへ通信モデム機能を持つデバイスが搭載され、高いセキュリティを持ちながら、クラウドコンピューティングを活用した各種ネットワークサービスに接続できる環境の実現が期待されています。

アルティア社の買収により、ソニーは今後、同社の既存ビジネスの拡大を図るのみならず、センシングデバイスにおける新たな技術開発も進めていきます。ソニーの持つ GNSS(Global Navigation Satellite System)、イメージセンサーを始めとするセンシングデバイス技術と、アルティア社の保有する高性能で低消費電力、低コストを実現するモデムチップ技術とを、さらに進化させて組み合わせることにより、通信機能を持った新たなセンシングデバイスの開発に向けて取り組んでまいります。

これにより、今後拡大が期待される IoT 機器やウェアラブル端末などに向けて、通信とセンシングの機能を併せ持つデバイスの提供と、これらデバイスを用いた LTE 通信によって実現できる新たなソリューションの提案を目指して参ります。

なお、本件取引が当社の 2015 年度連結業績に与える影響は軽微です。

**Altair Semiconductor (アルティア社) 概要**

本社所在地	イスラエル国 ホド・ハシャロン
CEO	Oded Melamed (オデッド メラメド)
従業員数	約 220 名
子会社所在地	アメリカ、中国、台湾
主な事業内容	LTE 向けモデムチップの開発と商品化

\* 1 ドル=118 円にて換算